

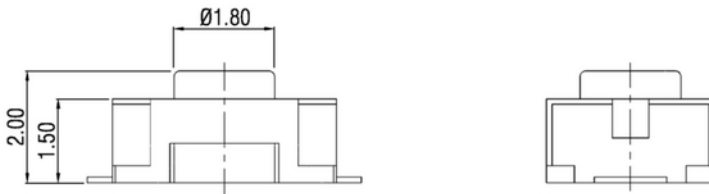
### Technische Daten / Technical Data

Gehäuse/Abdeckung/Hebel	Thermoplast/Stahl/Thermoplast, UL-94 HB
Case/Cover/Actuator	Thermoplastic/Steel/Thermoplastic, UL-94 HB
Kontaktmaterial	Messing
Contact Material	Brass
Kontaktbelastbarkeit	50mA, 12V <sub>DC</sub>
Contact Rating	50mA, 12V <sub>DC</sub>
Kontaktoberfläche	Versilbert
Contact Surface	Silver plated
Oberfläche Lötanschluss	Versilbert
Plating Solder Side	Silver plated
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 100mΩ im Auslieferungszustand
Contact Resistance	< 100mΩ at initial state
Isolationswiderstand	> 100MΩ im Auslieferungszustand
Insulation Resistance	> 100MΩ at initial state
Spannungsfestigkeit	250V <sub>AC</sub>
Test Voltage	250V <sub>AC</sub>
Temperaturbereich	-20°C ... +70°C
Temperature Range	-20°C ... +70°C
Mechanische Lebensdauer	min. 50 000 Schaltvorgänge (160g)
Mechanical Life	min. 20 000 Schaltvorgänge (250g)
	min. 50 000 operations (160g)
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
	Reflow soldering

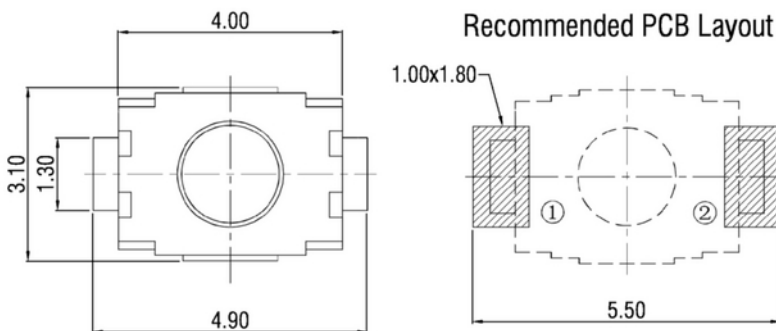


© W+P PRODUCTS

Das Foto zeigt diese Serien:  
The photo shows these series:  
**514 515 516 517**



### 517



<b>Series</b>	<b>Height</b>	<b>Force*</b>	<b>Packaging*</b>
<b>517</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>TR</b>
517 Einfachkontakte Single contacts	1 H=2.00mm	30 160g±30 40 250g±50	00 TR

### Lieferformen / Packing Options:

00 Schüttgut / Bulk goods  
TR Tape&Reel / Tape&Reel

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

## Informationen zum kurzen Reflow-Lötverfahren

### Fast Profile Reflow Soldering Information

### Reflow-Löttempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Temperatur Lötbereich $T_L$	230°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1,5°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C max.
Dauer Höchsttemperatur	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 4,5min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Soldering Range Temperature $T_L$	230°C
Duration above $T_L$	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1.5°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C max.
Duration Peak Temperature	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 4.5min